

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成20年5月8日(2008.5.8)

【公開番号】特開2002-83808(P2002-83808A)

【公開日】平成14年3月22日(2002.3.22)

【出願番号】特願2001-196819(P2001-196819)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/312 (2006.01)

H 0 1 L 21/301 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/312 B

H 0 1 L 21/78 L

【手続補正書】

【提出日】平成20年3月25日(2008.3.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ウェハ上にポリイミド溶剤を所定時間に複数回数ディスペンスするステップと、

ウェハ上にポリイミド溶剤をディスペンスする前記ステップに続いて、前記ウェハ上にポリイミドをディスペンスするステップとを含む、溶剤のコーティング方法。

【請求項2】 所定時間、前記ポリイミド溶剤をディスペンスする前記ステップはさらに、所定時間の間に、2ml以上の前記ポリイミド溶剤をディスペンスするステップを含む、請求項1に記載の溶剤のコーティング方法。

【請求項3】 所定時間、前記ポリイミド溶剤をディスペンスする前記ステップはさらに、所定時間の間に、実質的に2mlの前記ポリイミド溶剤をディスペンスするステップを含む、請求項1に記載の溶剤のコーティング方法。

【請求項4】 ウェハ上にポリイミド溶剤をディスペンスする前記ステップはさらに、前記ウェハを回転させるステップを含む、請求項1に記載の溶剤のコーティング方法。

【請求項5】 ウェハ上にポリイミド溶剤をディスペンスする前記ステップはさらに、静止位置に保持された前記ウェハ上に前記ポリイミド溶剤をディスペンスするステップを含む、請求項1に記載の溶剤のコーティング方法。

【請求項6】 ウェハ上にポリイミド溶剤をディスペンスする前記ステップはさらに、実質的に前記ウェハの中心点近くに前記ポリイミド溶剤をディスペンスするステップを含む、請求項1に記載の溶剤のコーティング方法。

【請求項7】 ウェハ上にポリイミド溶剤をディスペンスする前記ステップはさらに、前記ウェハ上にポリイミドの懸濁剤をディスペンスするステップを含む、請求項1に記載の溶剤のコーティング方法。

【請求項8】 ウェハ上にポリイミド溶剤をディスペンスする前記ステップはさらに、前記ウェハ上にN-メチル・ピロリドン(NMP)をディスペンスするステップを含む、請求項1に記載の溶剤のコーティング方法。

【請求項9】 前記ウェハ上に前記ポリイミド溶剤をディスペンスする前記ステップに続いて、前記ウェハ上にポリイミドをディスペンスする前記ステップはさらに、所定時間、前記ポリイミドをディスペンスするステップを含む、請求項1に記載の溶剤のコーティング方法。

【請求項 10】 所定時間、前記ポリイミドをディスペンスする前記ステップはさらに、所定時間の間に、1.15 g 以上のポリイミドをディスペンスするステップを含む、請求項 9 に記載の溶剤のコーティング方法。

【請求項 11】 所定時間の間に、1.15 g 以上のポリイミドを前記ウェハ上にディスペンスする前記ステップはさらに、所定時間の間に、1.3 g 以外の前記ポリイミドをディスペンスするステップを含む、請求項 10 に記載の溶剤のコーティング方法。

【請求項 12】 所定時間、前記ポリイミドをディスペンスする前記ステップはさらに、所定時間の間に、前記ポリイミド溶剤が前記ウェハ上にディスペンスされない場合に許容可能なウェハ性能を得るために必要なポリイミド量より少ない量のポリイミドをディスペンスするステップを含む、請求項 9 に記載の溶剤のコーティング方法。

【請求項 13】 前記ウェハはさらに、DRAM チップ以外のチップを包含する、請求項 1 に記載の溶剤のコーティング方法。

【請求項 14】 ウェハ上に物質の溶剤をディスペンスするステップと、ウェハ上に前記溶剤をディスペンスする前記ステップに続いて、前記ウェハ上に前記物質をディスペンスするステップとを含む、製造を改善するための溶剤のコーティング方法。

【請求項 15】 前記物質がポリイミドである、請求項 14 に記載の溶剤のコーティング方法。

【請求項 16】 ウェハ上に物質の溶剤をディスペンスする前記ステップはさらに、前記ウェハを回転させるステップを含む、請求項 14 に記載の溶剤のコーティング方法。

【請求項 17】 ウェハ上に物質の溶剤をディスペンスする前記ステップはさらに、静止位置に保持された前記ウェハ上に前記溶剤をディスペンスするステップを含む、請求項 14 に記載の溶剤のコーティング方法。

【請求項 18】 ウェハ上に物質の溶剤をディスペンスする前記ステップはさらに、実質的に前記ウェハの中心点近くに前記溶剤をディスペンスするステップを含む、請求項 14 に記載の溶剤のコーティング方法。

【請求項 19】 ウェハ上にポリイミド溶剤をディスペンスする前記ステップはさらに、前記ウェハ上に前記物質の懸濁剤をディスペンスするステップを含む、請求項 15 に記載の溶剤のコーティング方法。

【請求項 20】 ウェハ上に前記物質の懸濁剤をディスペンスする前記ステップはさらに、前記ウェハ上に N - メチル・ピロリドン (NMP) をディスペンスするステップを含む、請求項 19 に記載の溶剤のコーティング方法。